

Mech-Eye PRO

산업용 3D 카메라



MTBF(평균 고장 간격): $\geq 100,000$ 시간

- 고정확도 및 고속 캡처
- 고속 구조광 기술
- 컬러 버전 선택 가능
- 중거리 작업에 적합



빠른 스캔 속도



유연한 배포



방수&방진



경쟁력 있는 가격



범용 인터페이스

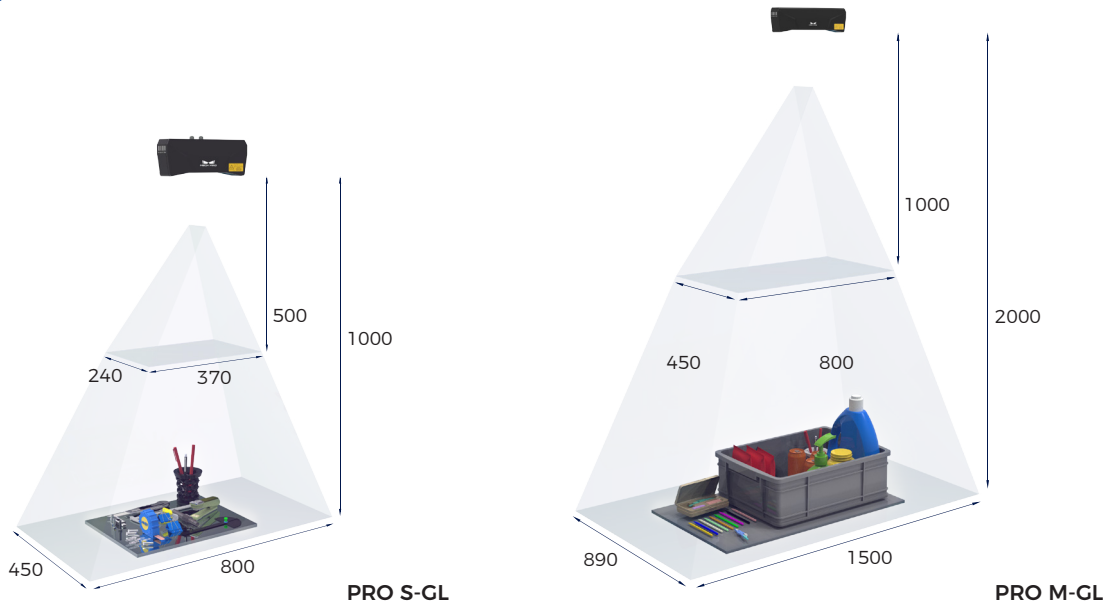
기술 사양

	PRO S-GL	PRO M-GL
작업 거리	500-1000 mm	1000-2000 mm
근거리 FOV	370 × 240 mm @ 0.5 m	800 × 450 mm @ 1.0 m
원거리 FOV	800 × 450 mm @ 1.0 m	1500 × 890 mm @ 2.0 m
해상도	1920 × 1200	1920 × 1200
메가픽셀	2.3 MP	2.3 MP
단일점의 Z방향 반복 정밀도(σ) ^[1]	0.05 mm @ 1.0 m	0.2 mm @ 2.0 m
VDI/VDE 측정 정밀도 ^[2]	0.1 mm @ 1.0 m	0.2 mm @ 2.0 m
일반적인 캡처 시간	0.3-0.6 s	0.3-0.6 s
치수	265 × 57 × 100 mm	353 × 57 × 100 mm
베이스라인	180 mm	270 mm
무게	1.6 kg	1.9 kg
광원	블루 LED(459 nm, RG2)/화이트 LED(RG2)	블루 LED(459 nm, RG2)/화이트 LED(RG2)
작업 온도 범위	0-45 °C	0-45°C
통신 인터페이스	기가비트 이더넷	기가비트 이더넷
입력	24V DC, 3.75A	24V DC, 3.75A
안전 및 전자파 적합성	CE/FCC/VCCI/KC/ISED/NRTL	CE/FCC/VCCI/KC/ISED/NRTL
보호 등급	IP65	IP65
냉각 방식	Passive	Passive
이미지 센서	하이엔드 머신 비전을 위한 Sony CMOS	하이엔드 머신 비전을 위한 Sony CMOS
MTBF(평균 고장 간격)	$\geq 100,000$ 시간	$\geq 100,000$ 시간

[1] 단일한 점의 Z 값에 대해 100 번 측정 후의 1배 표준 편차. 측정 대상은 세라믹 플레이트입니다.

[2] VDI/VDE 2634 Part II 표준을 기준으로 합니다.

시야(mm)

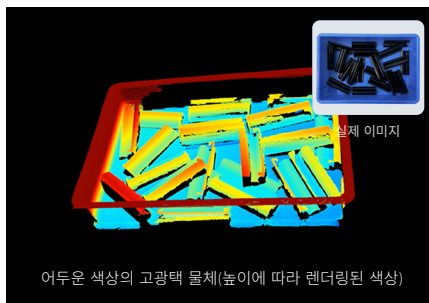
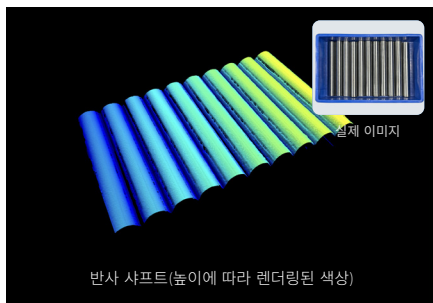


대표적인 물체에 대한 고품질 이미징

자체 연구 개발한 첨단 이미징 알고리즘을 통해 고광택 · 고반사 · 어두운 색상 · 투명한 재질 등 복잡한 시나리오를 지원하며, 금속, 플라스틱, 목재 등 다양한 재질의 물체에 대해 고정밀 작업이 가능합니다.



- Mech-Eye PRO 흑백 버전은 강한 환경광(> 20000lx)에서도 고품질의 이미징이 가능합니다.
- Mech-Eye PRO 컬러 버전은 다양한 색상을 가진 물체에 대한 정확한 색상 표현이 가능합니다.



Mech-Eye PRO가 일반적인 실내 조명에서 촬영한 3D 포인트 클라우드

응용 시나리오

랜덤 빈 피킹, 표지서닝, 조립 및 학술 연구와 같이 높은 정밀도가 요구되는 중거리 작업에 적합합니다.



Mech-Mind Robotics
 Business: info@mech-mind.net
 Marketing/PR: marketing@mech-mind.net
 Web: kr.mech-mind.com